

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 06-039958

(43)Date of publication of application : 15.02.1994

(51)Int.Cl.

B32B 5/28

B32B 15/08

H05K 1/03

(21)Application number : 04-217331

(71)Applicant : NITTO DENKO CORP

(22)Date of filing : 22.07.1992

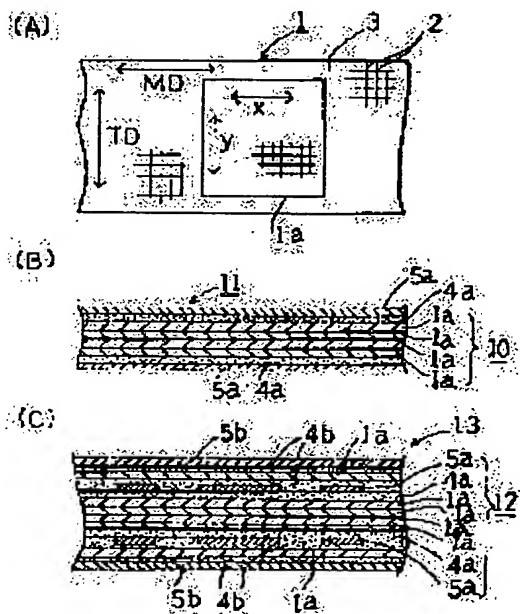
(72)Inventor : IWASAKI NAOTO
SHIBAGAKI KAZUYOSHI
MOTOGAMI MITSURU
ERIGUCHI FUYUKI

(54) FLUORINE RESIN-LAMINATED SHEET, CIRCUIT BOARD AND MULTI-LAYER CIRCUIT BOARD

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a multi-layer circuit board with a variation factor, of a prepreg to an initial size, which is almost the same both vertically and horizontally and the vertical and horizontal dimensional variation factors which are insignificant.

CONSTITUTION: A rectangular prepreg 1a which runs along the longitudinal direction (MD direction) on either of its vertical or horizontal side, is formed using a prepreg material 1 of a long fiber base material 2 impregnated with fluorine resin 3. When a required number of sheets of the prepreps 1a are stacked between adjacent layers so that the longitudinal direction of the base material is alternately intercrossed vertically and horizontally. Further, a metal foil 5a is provided on both surfaces of the prepreg 1a and is fused together to obtain a circuit board 11, and in turn, an inner circuit board 12 is manufactured using the circuit substrate 11. In addition, this circuit board 12 and a metal foil 5b provided on both surfaces of the circuit board 12 through a rectangular prepreg 1a, are used to constitute a multi-layer circuit board 13. The prepreg 1a is arranged so that the longitudinal direction of the base is alternately intercrossed vertically and horizontally between the prepreg 1a and the outermost prepreg 1a which constitutes the inner circuit board 12.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-39958

(43)公開日 平成6年(1994)2月15日

(51)Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
B 3 2 B	5/28	A 7016-4F		
	15/08	J		
H 0 5 K	1/03	K 7011-4E		

審査請求 未請求 請求項の数4(全 5 頁)

(21)出願番号 特願平4-217331

(22)出願日 平成4年(1992)7月22日

(71)出願人 000003964

日東電工株式会社

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号

(72)発明者 岩▲崎▼ 直人

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東
電工株式会社内

(72)発明者 柴垣 和芳

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東
電工株式会社内

(72)発明者 本上 満

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東
電工株式会社内

(74)代理人 弁理士 祢▲ぎ▼元 邦夫

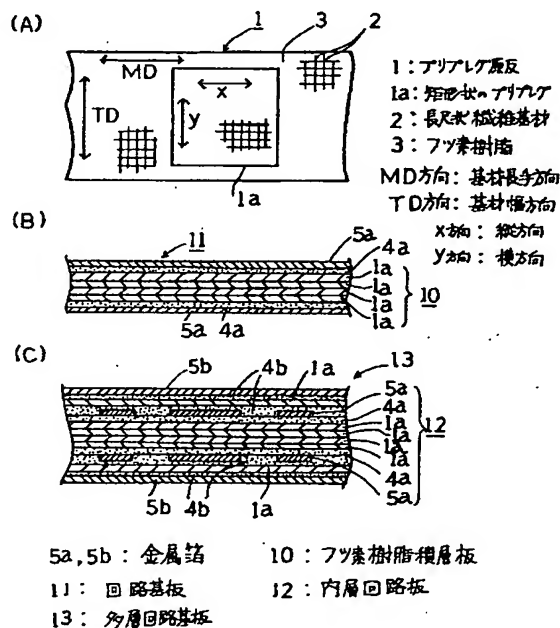
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 フッ素樹脂積層板、回路基板および多層回路基板

(57)【要約】

【目的】 プリブレグの初期寸法に対する変化率が、縦横でほぼ同じであつて、かつ縦横の寸法変化率が共に小さい多層回路基板を提供する。

【構成】 長尺状繊維基材2にフッ素樹脂3を含浸させたプリブレグ原反1から、縦横どちらかが基材長手方向(MD方向)に沿う矩形のプリブレグ1aを成形し、その所要枚数を、隣接層間で、基材長手方向が縦横交互となるように重ね合わせ、その両面に金属箔5aを設け、これらを融着一体化した回路基板11より内層回路板12を作製し、この回路板12とその両面に上記同様の矩形のプリブレグ1aを介して設けた金属箔5bとで多層回路基板13を構成させ、かつ上記後者のプリブレグ1aを、内層回路板12を構成する最外層のプリブレグ1aとの間で、基材長手方向が縦横交互となるように配置させる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 長尺状繊維基材にフツ素樹脂を含浸させてなるプリブレグ原反から、縦横どちらかが基材長手方向に沿う矩形形状のプリブレグを成形し、その所要枚数を、隣接層間で、基材長手方向が縦横交互となるように重ね合わせて、融着一体化してなるフツ素樹脂積層板。

【請求項2】 請求項1に記載のフツ素樹脂積層板の上下両面に金属箔が設けられてなる回路基板。

【請求項3】 請求項2に記載の回路基板を用いて作製した内層回路板と、その上下両面に請求項1に記載の矩形形状のプリブレグを介して設けた金属箔とからなる多層回路基板であつて、かつ上記のプリブレグは、内層回路板を構成する最外層のプリブレグとの間で、基材長手方向が縦横交互となるようにされている多層回路基板。

【請求項4】 請求項3に記載の多層回路基板において、内層回路板の上下両面側に設けられるプリブレグがそれぞれ2枚以上からなり、各プリブレグは、隣接層間で、基材長手方向が縦横交互となるようにされている多層回路基板。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、フツ素樹脂積層板と、この積層板の上下両面に金属箔が設けられてなる回路基板と、さらにこの基板から作製される回路板を内層回路板とした多層回路基板とに関するものである。

【0002】

【従来の技術】従来より、ガラスクロスなどの長尺状繊維基材にフツ素樹脂を含浸させ、これを矩形形状にしたプリブレグを、所要枚数重ね合わせて、加熱加圧により融着一体化して得られるフツ素樹脂積層板は、低誘電率材料として知られ、その上下両面に金属箔を設けた回路基板や、この基板より作製した回路板を内層回路板とした多層回路基板などは、電子機器、通信機器、コンピュータなどの高周波域利用機器などの種々の産業分野に利用されている。

【0003】ところで、近年のプリント配線板に対する性能向上の要求は厳しく、たとえば、機器の小型化のため、配線密度（実装密度）を高めることもその一つであり、そのためプリント配線板の寸法変化率の一層の低減が求められている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】しかるに、上記従来のフツ素樹脂積層板やその回路基板などは、その作製工程中に加わる熱によつて、縦横いずれかの方向の寸法変化が大きくなり、特に多層回路基板においてその傾向が著しく、プリント配線板の高性能化に伴う要求特性を十分に満足させるものではなかつた。

【0005】本発明は、このような事情に鑑み、寸法変化率、つまり板材として用いるプリブレグの初期寸法に対する変化率が、縦横でほぼ同じであつて、かつ縦横の

寸法変化率が共に小さいフツ素樹脂積層板やその回路基板などを提供することを目的としている。

【0006】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の目的を達成するため、鋭意検討した結果、フツ素樹脂積層板やその回路基板などの作製に用いられるプリブレグは、樹脂含浸時に基材長手方向に張力がかかり、同方向に伸びた状態になっており、これを樹脂含浸後縦横どちらかが基材長手方向に沿うように矩形形状に裁断、成形して、その所要枚数をすべて同方向に積層一体化すると、縦横どちらかが大きく熱収縮してしまうものであることがわかつた。

【0007】そこで、この知見をもとに、所要枚数のプリブレグの積層に際し、基材長手方向が隣接層間で縦横交互となるように重ね合わせて、熱収縮による寸法変化への影響を低減するようにしてみたところ、寸法変化率が縦横でほぼ同じで、かつ縦横の寸法変化率が共に小さいフツ素樹脂積層板やその回路基板などが得られることを見出し、本発明を完成するに至つた。

【0008】すなわち、本発明の第1は、長尺状繊維基材にフツ素樹脂を含浸させてなるプリブレグ原反から、縦横どちらかが基材長手方向に沿う矩形形状のプリブレグを成形し、その所要枚数を、隣接層間で、基材長手方向が縦横交互となるように重ね合わせて、融着一体化してなるフツ素樹脂積層板に係るものであり、また本発明の第2は、上記のフツ素樹脂積層板の上下両面に金属箔が設けられてなる回路基板に係るものである。

【0009】さらに、本発明の第3は、上記第2の発明に係る回路基板を用いて作製した内層回路板と、その上下両面に上記第1の発明で用いたのと同様の矩形形状のプリブレグを介して設けた金属箔とからなる多層回路基板であつて、かつ上記のプリブレグは、内層回路板を構成する最外層のプリブレグとの間で、基材長手方向が縦横交互となるようにされている多層回路基板に係るものである。

【0010】

【発明の構成・作用】以下、本発明を、図面を参考にして説明する。図1（A）は、プリブレグ原反から矩形形状のプリブレグを裁断、成形する態様を示す平面図、

（B）はこの矩形形状のプリブレグを用いて得たフツ素樹脂積層板とその上下両面に金属箔が設けられた回路基板、さらに（C）は上記基板を用いて作製した多層回路基板である。

【0011】（A）において、長尺状繊維基材2に通常その幅方向（TD方向）には張力を加えず、長手方向（MD方向）にのみ張力を加えた状態で、フツ素樹脂3を含浸させて、プリブレグ原反1を得、これより縦方向（x方向）と横方向（y方向）の長さが等しく、かつ縦横どちらか（ここでは縦方向）が基材長手方向に沿う正方形形状のプリブレグ1aを、複数枚、裁断、成形する。

【0012】長尺状繊維基材2としては、ガラス繊維、アスベスト繊維、アルミナ繊維、ボロン繊維、窒化ホウ素繊維、シリコーンカーバイド繊維などのほか、ポリテトラフルオロエチレン繊維、超高分子量ポリエチレン繊維、芳香族ポリエステル繊維などの有機繊維からなる織布や不織布などが用いられる。厚さは、特に限定されないが、通常50～300 μ m程度である。

【0013】フッ素樹脂3としては、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、テトラフルオロエチレン・パーフルオアルキルビニルエーテル共重合体(PFA)、テトラフルオロエチレンヘキサフルオロプロピレン共重合体(FEP)などの1種または2種以上を使用でき、特にPTFE70～95重量%とPFAおよび/またはFEP30～5重量%との混合物を用いるのが好ましい。

【0014】フッ素樹脂3の含浸率、すなわちプリブレグ原反1の重量(長尺状繊維基材2と含浸フッ素樹脂3との合計の重量)を m_0 、長尺状繊維基材2の重量を m_1 としたとき、 $\{(m_0 - m_1) / m_0\} \times 100$ で表される値として、通常55～85重量%程度であるのが望ましい。

【0015】(B)において、上記のプリブレグ1aを、隣接層間で、基材長手方向が縦横交互となるように4枚重ね合わせ、これを加熱加圧により融着一体化して、本発明のフッ素樹脂積層板10とする。ここで、上記のプリブレグ1aにあらかじめ基材長手方向(MD方向)と幅方向(TD方向)との識別を容易にするための適宜の処理、たとえば方向性を示す耐熱性有色インキを印刷処理しておく、と、上記交互の重ね合わせを容易に行うことができる。

【0016】また、上記の如く重ね合わせたプリブレグ1aの上下両面側に、さらにフッ素樹脂接着シート4aを介して金属箔5aを配設し、これらを上記プリブレグ1aと一緒に加熱加圧して融着一体化することにより、両面側に金属箔5aを有する本発明の回路基板11とする。

【0017】フッ素樹脂接着シート4aは、プリブレグ原反1のフッ素樹脂と同様のもの、つまりPTFE、PFA、FEPなどの厚さが通常15～100 μ mのものが用いられるが、場合により省くこともできる。金属箔5aは、銅箔、アルミニウム箔、ニッケル箔、ステンレス鋼箔などの厚さが通常18～70 μ mのものが用いられる。加熱加圧の条件は、プリブレグ1aや接着シート4aの樹脂分を熔融しうる温度で、通常10～50Kg/cm²程度の圧力とする。

【0018】(C)において、上記の回路基板11を用い、その両面の金属箔5aをパターン加工して回路板12を作製したのち、この回路板12の上下両面側に、プリブレグ1aを介して別の金属箔5bを配設し、かつ回路板12とプリブレグ1aとの間およびプリブレグ1a

と金属箔5bとの間にそれぞれフッ素樹脂接着シート4bを介在させ、これらを一緒に加熱加圧して融着一体化することにより、内層回路板12と外層用金属箔5bを有する本発明の多層回路基板13とする。

【0019】内層回路板12の作製において、金属箔5aのパターン加工は、通常のプリント回路板の製造と同様に、剥離現像型、溶剤現像型、アルカリ現像型などのフォトレジストを用いて行える。たとえば、回路基板11の金属箔5a表面にアルカリ現像型フォトレジスト層を形成し、その上からフォトマスクを介してパターン状に露光し、ついでフォトレジストの未露光部分をアルカリ現像液にて溶解除去して金属箔5aを部分的に露出させたのち、金属箔5aの露出部を化学的エッチングにより除去し、最後にフォトレジストの露光部を溶剤により除去すれば、フォトレジストの露光パターンの金属回路を有する回路板12が得られる。

【0020】この回路板12の上下両面側に設けられるプリブレグ1aは、回路板12を構成する最外層のプリブレグ1aとの間で、基材長手方向が縦横交互となるように重ね合わせることが必要で、こうすることにより融着一体化時の縦横どちらかへの熱収縮をうまく抑制できる。また、回路板12の上下両面側にそれぞれ2枚以上のプリブレグ1aを設ける場合は、回路基板11の作製の場合と同様に、隣接層間で、基材長手方向が縦横交互となるようにするのがよい。

【0021】回路板12とプリブレグ1aとの間およびプリブレグ1aと金属箔5bとの間にそれぞれ設けるフッ素樹脂接着シート4bは、前記のフッ素樹脂接着シート4aと同様のものを使用でき、その厚さは、15～100 μ mであるのがよい。なお、この接着シート4bは、必ずしも用いなくともよい。また、金属箔5bは、前記の金属箔5aと全く同様のものを使用できる。加熱加圧の条件は、プリブレグ1aや接着シート4bの樹脂分を熔融しうる温度で、通常10～50Kg/cm²程度の圧力とすればよい。

【0022】このようにして作製される多層回路基板13を用いて、その両面の金属箔5bに、内層回路板12の作製の場合と同様の手法でパターン加工を施して、所望の回路パターンを形成することにより、内外層に回路パターンを有する多層回路板を得ることができる。

【0023】なお、上記の図1では、プリブレグ原反1から正方形のプリブレグ1aを得ているが、図2に示すように、長方形のプリブレグ1b、1cを得るにしてもよい。この場合、一方のプリブレグ1bは縦方向(x方向)が基材長手方向(MD方向)に沿うように、他方のプリブレグ1cは横方向(y方向)が基材長手方向に沿うように〔つまり、縦方向が基材幅方向(TD方向)に沿うように〕、それぞれ裁断、成形し、この2種のプリブレグ1b、1cを交互に重ね合わせ、前記同様の一体化処理を施すことにより、隣接層間で基材長

手方向が縦横交互となる、図1と同様のフツ素樹脂積層板10、回路基板11および多層回路基板13を作製することができる。

【0024】

【発明の効果】以上のように、本発明においては、長尺状繊維基材にフツ素樹脂を含浸させてなるプリブレグ原反から、縦横どちらかが基材長手方向に沿う矩形のプリブレグを成形して、その所要枚数を隣接層間などで基材長手方向が縦横交互となるように重ね合わせて融着一体化させるようにしたことにより、寸法変化率が縦横でほぼ同じであつて、かつ縦横の寸法変化率が共に小さいフツ素樹脂積層板、回路基板および多層回路基板を得ることができる。

【0025】

【実施例】つぎに、本発明の実施例を記載して、より具体的に説明する。

【0026】実施例1

<内層回路板の作製>厚さが50 μ mの長尺状ガラスクロス〔日東紡(株)製のWEA05E〕に、ポリテトラフルオロエチレンディスパージョン〔三井・デュボン・フロケミカル(株)製の3443-J〕を含浸率77重量%で含浸したプリブレグ原反より、縦横同寸の正方形形状のプリブレグを裁断、成形した。

【0027】この正方形形状のプリブレグを、ガラスクロスの長手方向(MD方向)が基板の縦方向(x方向)、つぎに同方向が基板の横方向(y方向)と、交互になるように、4枚重ね合わせ、その上下両面に厚さ50 μ mのPTFEシート、つぎに厚さ35 μ mの銅箔〔古河・サーキットフオイル(株)製の電解銅箔〕を配置し、これらを390℃、圧力50Kg/cm²で30分間加熱加圧して、内層用回路基板を得た。つぎに、この基板の銅箔をアルカリ現像型フォトレジストを用いてパターン加工して、内層回路板を作製した。

【0028】<多層回路板の作製>この内層回路板の上下両面に、厚さ25 μ mのFEPシート〔東レ(株)製〕、つぎに内層回路板を構成する最外層のプリブレグとの間でガラスクロスの長手方向(MD方向)が縦横交互する同上プリブレグ、さらに厚さ25 μ mのFEPシートを介して、厚さ18 μ mの銅箔〔古河・サーキットフオイル(株)製の電解銅箔〕を配置し、これらを温度300℃、圧力10Kg/cm²で30分間加熱加圧して、多層回路基板を得た。

【0029】つぎに、この基板の銅箔をアルカリ現像型フォトレジストを用いてパターン加工して、多層回路板を作製した。この多層回路板は、用いたプリブレグの原寸に比べ、縦横の寸法変化率が共に-0.04%という非常に小さい値であつた。

【0030】比較例1

多層回路板の作製において、内層回路板の上下両面に配置するプリブレグを、内層回路板を構成する最外層のプ

リブレグとの間でガラスクロスの長手方向(MD方向)が同方向となるようにした以外は、実施例1と同様にして、多層回路板を作製した。この回路板は、横方向の寸法変化率が-0.04%であつたのに対し、縦方向の寸法変化率が0.08%と大きかつた。

【0031】比較例2

内層回路板の作製において、4枚のプリブレグをガラスクロスの長手方向(MD方向)が同方向となるように重ね合わせた以外は、実施例1と同様にして、多層回路板を作製した。この回路板は、横方向の寸法変化率が-0.05%であつたのに対し、縦方向の寸法変化率が0.10%と大きかつた。

【0032】比較例3

内層回路板の作製において、4枚のプリブレグをガラスクロスの長手方向(MD方向)が同方向となるように重ね合わせ、かつ多層回路板の作製において、内層回路板の上下両面に配置するプリブレグを、内層回路板を構成する最外層のプリブレグとの間でガラスクロスの長手方向(MD方向)が同方向となるようにした以外は、実施例1と同様にして、多層回路板を作製した。この回路板は、横方向の寸法変化率が-0.04%であつたのに対し、縦方向の寸法変化率が0.12%と非常に大きかつた。

【図面の簡単な説明】

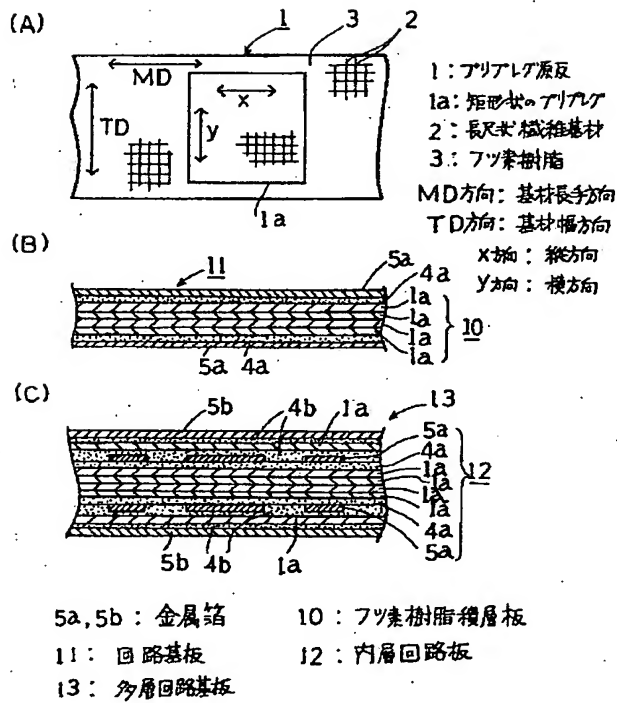
【図1】本発明のフツ素樹脂積層板、回路基板および多層回路基板の説明図で、(A)はプリブレグ原反から矩形形状のプリブレグを裁断、成形する態様を示す平面図、(B)はこの矩形形状のプリブレグを用いて得たフツ素樹脂積層板とその両面に金属箔が設けられた回路基板を示す断面図、(C)は上記回路基板を用いて作製した多層回路基板を示す断面図である。

【図2】本発明のプリブレグ原反から矩形形状のプリブレグを裁断、成形する別の態様を示す平面図である。

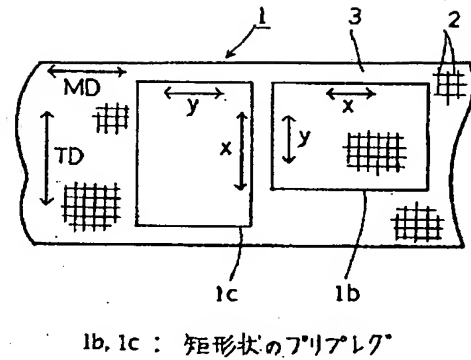
【符号の説明】

- 1 プリブレグ原反
- 1 a, 1 b, 1 c 矩形形状のプリブレグ
- 2 長尺状繊維基材
- 3 フツ素樹脂
- 5 a, 5 b 金属箔
- 10 フツ素樹脂積層板
- 11 回路基板
- 12 内層回路板
- 13 多層回路基板
- MD方向 基材長手方向
- TD方向 基材幅方向
- x方向 矩形形状のプリブレグ(ないし積層板および基板)の縦方向
- y方向 矩形形状のプリブレグ(ないし積層板および基板)の横方向

【図1】



【図2】



フロントページの続き

(72)発明者 江里口 冬樹
大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東
電工株式会社内